

11 間接法レジンコア【ファイバーポスト】



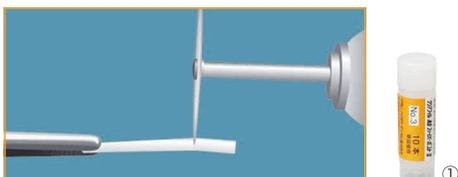
クリアフィル® DCコア
オートミックス® ONE

通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞の形成、印象採得等を行ってください。

1 模型を製作



2 ポストの試適、切断、清掃



3 ポストの表面処理

① リン酸処理
水洗・乾燥
5秒間処理

例えば ②

② シラン処理 (「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」)
塗布・エアブローで乾燥
待ち時間なしでエアブロー

③

関連商品

- 歯科根管用ポスト ① クリアフィル® AD ファイバーポスト II
- 歯科用エッチング材 ② K エッチャント シリンジ
- 歯科セラミックス用 ③ クリアフィル® セラミック プライマー プラス 接着材料

※製品画像に付与された番号を参照ください。

4 分離材を塗布



5 ペーストの填入



6 ポスト植立・光照射



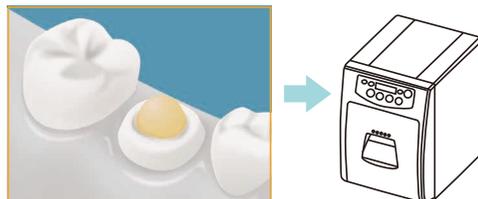
光照射については下記表をご参照ください。

7 ペースト築盛



操作可能時間 (23℃遮光下) ミキシングチップを通して練和開始後3分

8 光照射※・支台歯形成



光照射については下記表をご参照ください。

ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	光源	光量	照射時間	硬化深度
LED照射器	青色LED	300 mW/cm ² 以上	10秒	1.5 mm
			20秒	2.0 mm
ハロゲン照射器	ハロゲンランプ	300 mW/cm ² 以上	10秒	1.5 mm
			20秒	2.0 mm

ペーストへの照射時間と硬化深度の関係(歯科重合用光照射)

照射器	照射時間	硬化深度
アルファライトII ¹⁾	120秒	3.0 mm
アルファライトIIIN ¹⁾		3.0 mm
アルファライトIII ¹⁾	180秒	5.0 mm

1) 製造販売元:株式会社モリタ 東京製作所

POINT ※ 光硬化深度以上に築盛する場合は10分以上静置してください。

本術式は「クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE」電子添文等記載の「間接法による支台築造」を示します。

直接充填

セメンテーション

支台築造

リペア

知覚過敏の処置

歯面コーティング